

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年9月17日(17.09.2015)

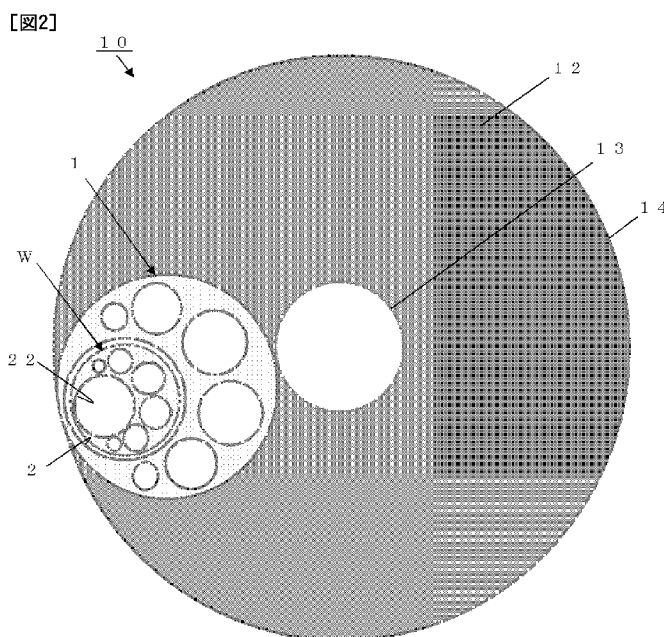


(10) 国際公開番号
WO 2015/136840 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/28 (2012.01) *H01L 21/304* (2006.01)
B24B 37/08 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/000662
- (22) 国際出願日: 2015年2月13日(13.02.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-051332 2014年3月14日(14.03.2014) JP
- (71) 出願人: 信越半導体株式会社 (SHIN-ETSU HAN-
DOTAI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1000004 東京都千代田
区大手町二丁目6番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 佐藤 一弥(SATO, Kazuya); 〒9618061 福
島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平150番
地信越半導体株式会社 半導体白河研究所内
Fukushima (JP). 田中 佑宜(TANAKA, Yuki); 〒
9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大
平150番地信越半導体株式会社 半導体白河
研究所内 Fukushima (JP). 小林 修一(KOBAY-
ASHI, Syuichi); 〒9618061 福島県西白河郡西郷村
大字小田倉字大平150番地信越半導体株式会
社 半導体白河研究所内 Fukushima (JP).
- (74) 代理人: 好宮 幹夫(YOSHIMIYA, Mikio); 〒
1100005 東京都台東区上野7丁目6番11号第
一下谷ビル8F Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユー
ラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨー
ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING DOUBLE-SIDED POLISHING DEVICE CARRIER, DOUBLE-SIDED POLISHING DEVICE CARRIER, AND DOUBLE-SIDED POLISHING METHOD

(54) 発明の名称: 両面研磨装置用キャリアの製造方法及び両面研磨装置用キャリア並びに両面研磨方法



(57) Abstract: The present invention is a method for manufacturing a double-sided polishing device carrier by lapping a double-sided polishing device carrier that is geared and has a holding hole for holding a semiconductor wafer, characterized in that: an outer carrier that has a hole for holding the double-sided polishing device carrier and is larger than the double-sided polishing device carrier is prepared, the center of the hole being eccentric to the center of the outer carrier; the double-sided polishing device carrier is placed and held inside the hole; and the double-sided polishing device carrier is lapped in a state in which the center of the hole is eccentric to the center of the outer carrier. This allows for the provision of a method for manufacturing a double-sided polishing device carrier, a double-sided polishing device carrier, and a double-sided polishing method using the double-sided polishing device carrier, such that variations in thickness distribution during lapping of the double-sided polishing device carrier can be reduced.

(57) 要約:

[続葉有]



本発明は、半導体ウェーハを保持するための保持孔が形成された歯車形の両面研磨装置用キャリアをラッピング加工して両面研磨装置用キャリアを製造する方法であって、両面研磨装置用キャリアを保持するためのホールを有し両面研磨装置用キャリアよりも大きいサイズのアウターキャリアを用意し、ホールの中心がアウターキャリアの中心に対し偏芯したものとし、ホールに両面研磨装置用キャリアを収納して両面研磨装置用キャリアを保持し、ホールの中心がアウターキャリアの中心に対して偏芯した状態で両面研磨装置用キャリアをラッピング加工することを特徴とする両面研磨装置用キャリアの製造方法である。これにより、両面研磨装置用キャリアをラッピングする場合に発生する厚み分布のバラツキを改善できる両面研磨装置用キャリアの製造方法、両面研磨装置用キャリア並びにこの両面研磨装置用キャリアを用いた両面研磨方法が提供される。